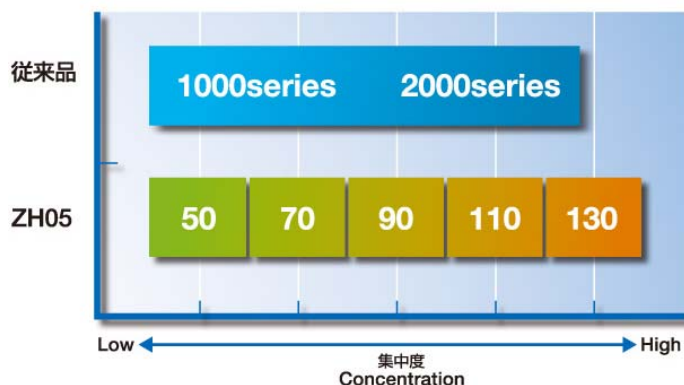
ZH05SERIES

さらなる安定性を追及したハブブレード

高精度な集中度コントロール技術により、安定した加工結果を提供するZH05シリーズ

新たに開発した集中度コントロール技術を用い、5段階の集中度ラインアップを用意しました。この集中度細分化により、品質（特に裏面チッピング）とライフのバランスがとれたブレードをご使用いただくことができます。

- さまざまな要求に応える5段階の集中度ラインアップ
- プリカット短縮、チップ飛び破損低減技術も採用

■集中度範囲

集中度※は、ダイシング加工において消耗量（ライフ）に影響し、その集中度を高精度に制御することで、消耗量と品質をより安定化させることが可能です。

※集中度とは、ブレードに含まれているダイヤモンド砥粒の割合を示す値です。
例えば集中度100とは、体積の25%を砥粒が占めている状態です。

加工対象	シリコンウェーハ、化合物半導体ウェーハ(GaAs、Gapなど)、酸化物ウェーハ（$LiTaO_3$など）、他

仕様

集中度
50
70
90
110
130

ボンド
N1

特殊仕様

角度
θ

砥粒種類
SD

粒径	
1500	#1500
1700	#1700
1800	#1800
2000	#2000
2500	#2500
3000	#3000
3500	#3500
4000	#4000
4500	#4500
4800	#4800
5000	#5000

刃先出し量	
A	0.38 - 0.51
B	0.51 - 0.64
C	0.64 - 0.76
D	0.76 - 0.89
E	0.89 - 1.02
F	1.02 - 1.15
G	1.15 - 1.28
H	1.28 - 1.41
I	1.41 - 1.54
J	1.54 - 1.67
K	1.67 - 1.80

(mm)

カーフ幅	
A	0.015 - 0.020
B	0.020 - 0.025
C	0.025 - 0.030
D	0.030 - 0.035
E	0.035 - 0.040
F	0.040 - 0.050
G	0.050 - 0.060
H	0.060 - 0.070
I	0.070 - 0.080
J	0.080 - 0.090
K	0.090 - 0.100
L	0.100 - 0.110

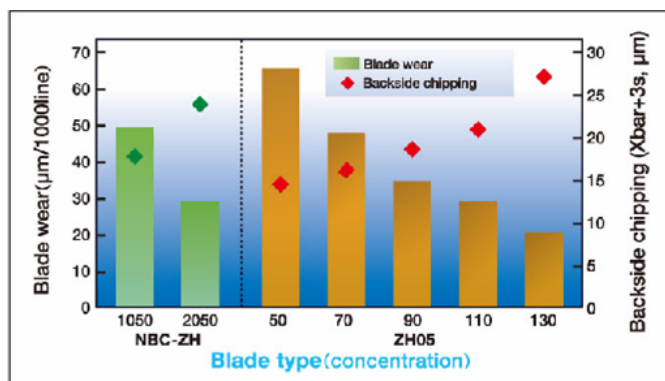
(mm)

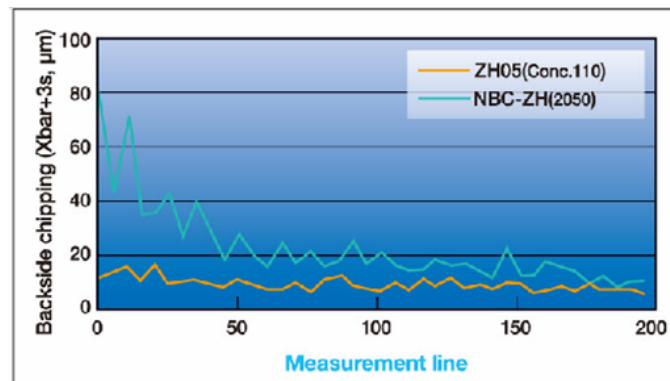
先端形状※	
E	N
MA	MB
VA	VB
S 特殊仕様	

※ブレード厚さ0.1mm(Lカーフ)以上より対応可能です

実験データ

ZH05は集中度の選択肢が増えたことにより、お客さまの要望にきめ細かくお応えすることができます。また、プリカット短縮効果も期待できます。

■消耗量と裏面チッピングの関係

Workpiece	: Si+Oxide layer φ6”
Depth	: 400 μm (full cut)
Feed speed	: 60 mm/s
Spindle revolution	: 30,000 min⁻¹

■プリカット短縮効果

Workpiece	: Si φ6”
Depth	: 400 μm (full cut)
Feed speed	: 10, 20, 30 mm/s (each of 10lines) 40, 50 mm/s (each of 20lines) 60 mm/s (each of 130lines)
Spindle revolution	: 30,000 min⁻¹

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・外径・厚さ・内径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当員が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。

・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますので、ご確認の上ご発注くださいますようお願い申し上げます。

安全にご使用いただくために

ブレード、ホイール(以下、精密加工エツール)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- ●安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- ●制限回転数表示のある精密加工エツールは指定の回転数を超えて使用しないでください。
- ●精密加工エツールを装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- ●精密加工エツールを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ●使用する際には必ず毎回精密加工エツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ●ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ●改造された機械(装置)は使用しないでください。
- ●機械(装置)指定サイズに合わない精密加工エツールは使用しないでください。
- ●切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- ●湿式切断の精密加工エツールは冷却液をご使用ください。

DISCO CORPORATION
www.disco.co.jp